

## 奇景光電發佈正面照光 LCoS 專利新技術

[台南,2014年6月6日] 奇景光電 (納斯達克代號: HIMX) 今日發佈正面照光 LCoS 專利新技術。此項全新專利技術由奇景光電控股的子公司立景光電(Himax Display Inc.)所提出,目前正在美國聖地牙哥國際資訊顯示學會(Society for Information Display ,簡稱 "SID")專業顯示器展「2014顯示周」(Display Week 2014)首度展出。這項集成式的 LCoS 光學模組,簡稱為"正面照光 LCoS" ("Front-Lit™ LCoS"),是目前頭戴式顯示器產業最重大的技術突破。

奇景光電全新的正面照光 LCoS 模組,讓頭戴式顯示器裝置客戶可以設計出業界最小巧、最高效能的微顯示光學系統。此技術將傳統典型光學引擎內的兩個主要功能,成功整合到 LCoS 微顯示器模組內,該兩個功能分別是 LED 照明系統和偏極化分光鏡(PBS)。此獨特技術的優勢是可縮小光學引擎的尺寸,並大爲改善其功耗。同樣重要的是,此技術可顯著簡化光學引擎設計及組裝過程,幫助客戶降低製造光學引擎的複雜度及成本。上述優勢,均是目前頭戴式裝置急需的關鍵突破,此乃奇景光電自行開發並擁有專利的獨特技術。

奇景光電的正面照光 LCoS 專利技術已具體符合頭戴式裝置深切期待的特性,包括色澤豐富而明亮的微顯示器,小巧的外型,以及低功耗的效能。正面照光 LCoS 微顯示器可發出超過 10,000 尼特的亮度及超過 50 尼特/毫瓦的效率,這是目前全球業界所能達到的最高光效率。該技術聰明地結合了以下三種穿戴式技術的優勢,第一是類似 OLED 光學引擎簡單的製造技術,第二是高光效率的 LCoS,第三是 LCoS 解析度的容易客製化。該創新技術於 SID 現場得到現有客戶及市場的熱烈反應。

奇景光電執行長吳炳昌表示:「奇景是不斷追求創新的公司」,「奇景工程師,爲配合頭戴式裝置領導品牌客戶及設計者深具挑戰的要求,不斷改良且創造科技新猷。對於穿戴式技術以及發展中的虛擬實境市場,奇景的正面照光 LCoS 專利技術是近來業界最重大的技術突破。我爲奇景團隊的創新能力感到自豪,並期待團隊正爲LCoS 客戶及未來潛在消費者開發的每一個新產品。」

奇景光電在 LCoS 顯示器的設計及生產已超過十年,客戶群包括頂尖品牌與專攻利基市場的廠商。奇景光電目前在台灣的 LCoS 生產線,擁有每個月最高曾達 30 萬片的出貨實績,在目前生產地點,奇景亦同時擁有每個月快速擴大至 200 萬片的產能。

## 關於奇譽光雷:

奇景光電股份有限公司(納斯達克代號: HIMX)為一個專注於影像顯示處理技術之 IC 設計公司。本公司係全球顯示器驅動 IC 與時序控制 IC 領先廠商,產品應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、汽車導航以及其他多種消費性電子產品。奇景光電的其他產品並包含觸控面板控制 IC、手持式與頭戴式矽控液晶光閥(LCOS)微型投影解決方案、LED 驅動 IC、電源管理 IC、監視器及投影機控制晶片、客製化影像處理晶片解決方案及提供矽智權的授權等。奇景光電亦提供數位相機解決方案,包括 CMOS 影像感測 IC 及晶圓級鏡頭,這些產品已被廣泛地應用在手機、平板電腦、筆記型電腦、電視、網路攝影機、汽車、保全及醫療器材等。奇景光電設立於 2001 年,總部位於台灣台南,目前員工人數約 1,600 人,分布於台南、新竹、台北、中國、韓國、日本與美國。至 2014 年 3 月 31 日爲止,奇景光電在全球已取得 2,287 項專利,尚有 953 項專利正在申請中,產品應用於全球各種消費性電子品牌產品,技術領先並維持影像顯示處理技術半導體解決方案領導廠商的地位。

## 聯絡人:

黃華珮 / Jessica Huang 媒體關係 專案經理 奇景光電股份有限公司 Himax Technologies, Inc. +886-3-516-3276 分機 38817 jessica huang@himax.com.tw 林威宇 / Steven Lin 投資人關係 經理 奇景光電股份有限公司 Himax Technologies, Inc. +886-2-2370-3999分機 22320 stevenwy lin@himax.com.tw John Mattio
Investor Relations – US
Representative
Senior Vice President
MZ North America
Tel: +1-212-301-7130
john.mattio@mzgroup.us

## 風險說明:

本新聞稿的部分展望未來的陳述,特別是有關於財務、產業預測,可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同,可能造成差異的因素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對本公司驅動 IC 產品及非驅動 IC 產品之接受度、產品競爭力、市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才,包括本公司為 2013 年度所申報的 20-F 文件中「風險因素」標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件,本公司皆無義務公開更新或修改此風險說明。